

臻宝科技：发展新质生产力 成为世界一流半导体零部件整体解决方案智造者

——重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

重庆臻宝科技股份有限公司董事长、总经理
重庆臻宝科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书

王兵先生
张静女士

中信证券股份有限公司保荐代表人
中信证券股份有限公司保荐代表人

杨腾先生
韩潇女士

重庆臻宝科技股份有限公司 董事长、总经理王兵先生致辞



公司逐步拓展集成电路先进制程等离子体刻蚀、薄膜沉积设备零部件，以及显示面板高世代线、AMOLED 电极产品及表面处理服务。

目前，公司已构建“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，还自主开发了加工刻蚀液、加工工具和装置，是国内少数实现集成电路先进制程设备和高世代、高电压显示面板制造设备非金属材料多品类供应、规模化量产的企业之一。

近几年，公司经营业绩实现了持续稳健增长，营业收入从 2023 年的 5.06 亿元增长至 2025 年的 8.68 亿元，归母净利润从 1.09 亿元增长至 2.26 亿元，良好的增长态势为公司长远发展筑牢根基。

如今，我们即将登陆资本市场，这是公司发展的全新起点。以上市为契机，臻宝科技将更好地携手合作伙伴、服务客户需求、稳步推进高质量发展。未来，公司将致力于成为关键半导体设备腔体内非金属材料整体方案提供方，助力客户向更先进制程、更多堆叠层数的集成电路芯片制造工艺升级，追赶世界领先水平。同时，我们诚挚希望各位借助本次网上路演畅所欲言、建言献策，我们将秉持诚信尽责的态度，逐一解答大家关心的问题，深入交流。

最后，再次感谢各位对臻宝科技的关注与支持！祝愿各位身体健康、工作顺利！谢谢大家！

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：大家好！

今天，我们怀着诚挚的心情相聚上证路演中心、上海证券报·中国证券网，就重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行交流。首先，我谨代表公司全体员工，向长期以来关心、支持臻宝科技发展的各级领导、合作伙伴、投资者及社会各界朋友，表示衷心的感谢！向参与本次网上路演的各位嘉宾和网友，致以最热烈的欢迎！

臻宝科技成立于 2016 年，自设立以来专注于集成电路及显示面板刻蚀、薄膜沉积和蒸镀设备真空腔内零部件及零部件表面处理服务，自主研发成熟制程等离子体刻蚀设备零部件，及 TFT LCD 显示面板用下部电极。

中信证券股份有限公司 保荐代表人杨腾先生致辞



“原材料—零部件—表面处理”协同发展的完整业务链条。凭借过硬的技术与产品，公司赢得了国内主流半导体、显示面板企业的深度信赖，持续助力客户实现制造工艺与核心设备零部件的迭代升级。如今，国产半导体产业链自主可控大方向向好，行业空间持续扩容，公司发展前景值得期待。

作为本次发行的保荐机构，中信证券坚守专业初心，严把合规与质量关口。通过系统、细致的尽职调查，我们深切感受到臻宝科技深耕实业的定力、持续创新的活力与规范运营的能力。报告期内，公司经营有序、业绩快速攀升，综合实力亮眼。未来，我们将以全链条的金融服务，助力公司抢抓行业机遇，实现跨越式发展。

资本市场是企业成长的沃土，更是投资者携手共赢的平台。我们期待，登陆科创板后的臻宝科技，能够不忘初心、砥砺前行，以技术立身、以品质致远，用稳健的发展成果回馈广大投资者，与所有伙伴共赴产业发展新未来。欢迎各位沟通交流、互动探讨。

最后，衷心祝愿臻宝科技本次公开发行股票圆满成功！愿公司借力资本市场东风，深耕主业、行稳致远！谢谢大家！

尊敬的各位投资者、各位网友：大家好！

今天，我们齐聚云端，和广大投资者就重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行交流。在此，我谨代表本次发行的保荐人及主承销商中信证券，向每一位关注臻宝科技、赋能国产半导体产业的投资者与业界同仁，致以最诚挚的欢迎与谢意！

我们由衷祝贺臻宝科技即将登陆资本市场，开启企业高质量发展的全新篇章。深耕半导体设备零部件及关键原材料领域多年，公司攻克多项关键技术壁垒，构建起

重庆臻宝科技股份有限公司 董事、财务负责人、董事会秘书张静女士致结束语



心的敬意！同时，感谢上证路演中心、上海证券报·中国证券网为我们提供优质的沟通平台。

今天的交流中，大家提出了很多宝贵的意见和建议，我们都会认真吸纳，融入后续的经营管理中。近几年，公司凭借扎实的业务能力，实现了营业收入与净利润的双增长。未来，我们将继续保持这一良好发展势头，以更优异的业绩回报大家的信任与支持。公司经营将持续紧扣国家产业政策和科技创新战略，坚持面向经济主战场、聚焦产业链自主可控，深耕半导体和显示面板产业链关键核心领域，依托“原材料+零部件+表面处理”的一体化业务平台，持续为客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案，为投资者创造长期稳定的价值回报。

今天的路演即将结束，但我们与投资者的共赢之路才刚刚启程。真诚欢迎大家继续关注臻宝科技，与我们保持沟通交流。

最后，再次感谢各位投资者对臻宝科技的信任与支持！谢谢大家！

尊敬的各位投资者朋友、各位网友：大家好！

重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动已接近尾声，非常感谢大家的积极参与和热情互动。在此，我谨代表公司全体员工，向在百忙之中参与本次路演的每一位投资者朋友、网友，表示最诚挚的感谢！向保荐机构中信证券股份有限公司及所有中介机构伙伴们的专业赋能与辛勤付出，致以最衷



经营篇

问：公司的主要业务和产品是什么？

王兵：公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案，主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。公司的零部件产品和表面处理服务主要应用于集成电路行业等离子体刻蚀、薄膜沉积等工艺的半导体设备和显示面板行业等离子体刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等工艺的面板制造设备。公司已量产大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积高纯碳化硅超厚材料和陶瓷造粒粉体等半导体材料，形成“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，并不断突破关键半导体材料制备技术和表面处理技术，拓展核心零部件产品品类，向客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案。

问：公司有多少子公司、参股公司及分公司？

王兵：截至 2025 年底，公司共有 7 家全资子公司，无参股公司，6 家分公司（含公司子公司之分公司）。全资子公司有：上海臻宝电子科技有限公司、上海升芯电子有限公司、重庆芯洁科技有限公司、湖北芯洁电子科技有限公司、GENORI SINGAPORE PTE.LTD.、重庆臻宝半导体材料有限公司、上海臻宝技术有限公司；分公司有：重庆臻宝科技股份有限公司合肥分公司、深圳分公司、武汉分公司、上海分公司、成都分公司、湖北芯洁电子科技有限公司武汉分公司。

问：请介绍公司零部件产品的业务开展情况。

韩潇：公司已量产曲面上部电极、石英气体分配盘、高纯碳化硅环等核心零部件产品，并批量供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3DNAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，处于国内领先地位。公司已在显示面板领域实现 G10.5-G11 超大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工艺制造设备中的静电卡盘以及 PVD 设备中的双极静电卡盘等关键零部件的自主可控。

问：请介绍公司原材料制造业务的开展情况。

韩潇：原材料制造方面，公司已量产用于硅零部件生产的大直径单晶硅棒、用于高纯碳化硅零部件生产的化学气相沉积碳化硅材料和用于陶瓷零部件生产的氧化铝、氧化铝陶瓷造粒粉，持续推进高精密陶瓷涂层制备工艺的迭代开发。公司原材料的自主生产提升了产品质量和定制化零部件的研发生产能力，保障了公司供应链的稳定。

问：请介绍公司表面处理业务的开展情况。

韩潇：在集成电路制造领域，公司表面处理服务已供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造和存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造。在显示面板领域，公司表面处理服务已供应于 G10.5-G11 超大世代和 AMOLED 等显示面板高端工艺制程。

问：公司的主营业务毛利是多少？

杨腾：报告期内（2023—2025 年度，下同），公司主营业务毛利分别为 21416.29 万元、30189.78 万元和 41157.08 万元，随着业务规模增加，公司毛利水平逐年提高。报告期内，公司毛利主要来源于半导体行业产品和服务。公司主要产品各期的毛利持续增长，主要系公司在报告期内保持对下游半导体领域零部件新产品的研发，并持续开发新客户所致。

问：公司的综合毛利率是多少？

杨腾：报告期内，公司综合毛利率分别为 42.45%、47.81% 和 49.85%。其中，半导体行业产品毛利率分别为 54.07%、56.57% 和 55.67%，显示面板行业产品毛利率分别为 22.92%、25.04% 和 24.74%。报告期内，半导体行业产品毛利率整体较高，主要受益于国内巨额的半导体投资、国产化率不断提升和国内厂商在先进工艺领域的快速迭代；显示面板行业产品毛利率较半导体行业产品毛利率偏低，主要受显示面板行业国产化程度较高、国内供应链配套已较为成熟和行业发展速度下降等影响。

发展篇

问：公司未来的发展战略与总体规划是什么？

王兵：公司未来将继续推动集成电路和显示面板干法刻蚀和薄膜沉积等设备的核心零部件自主可控，保障供应链的安全性和稳定性。公司紧扣国家产业政策和科技创新发展战略，持续加大技术研发投入，提升国产零部件技术水平和产品

性能，不断拓展产品品类，推动碳化硅零部件、石墨零部件、静电卡盘、氮化铝加热器等高附加值产品量产和高精密涂层等表面处理技术的研发。同时，向单晶硅棒、化学气相沉积碳化硅和陶瓷造粒粉体等上游材料领域持续投入研发资源，致力于夯实“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，协同上下游产业链创新发展，建立安全可控的供应链，力争成为具有自主新质生产力、国内领先、世界一流的中国半导体零部件整体解决方案智造者。

问：公司在研发人员、技术团队方面有哪些亮点？

韩潇：截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 145 名研发人员，61 项已授权发明专利，50 项在申请发明专利。报告期内，公司研发费用分别为 2701.63 万元、5119.27 万元和 6116.94 万元，研发费用率分别为 5.34%、8.07% 和 7.05%。公司通过自主培养、人才引进等方式组建了以核心技术骨干为骨干的技术研发团队。研发团队核心成员均为行业内资深专家，具有专业的理论基础和丰富的产业经验，主导了公司集成电路及显示面板设备零部件的制造工艺研发、先进精密陶瓷材料的制备技术及涂层工艺研发和设备零部件表面处理工艺研发等，公司具有较强的研发技术创新能力。

问：公司的技术发展情况如何？

韩潇：公司具备坚实的研发能力，在硅、碳化硅等半导体材料的制备环节，形成了大直径单晶硅棒控制和碳化硅气相沉积等关键材料制备技术；在硅、石英、陶瓷和碳化硅等硬脆半导体材料的高精密加工环节，形成了微深孔精密制造、曲面精加工和微深孔刻蚀等精密加工技术；在零部件表面处理环节，覆盖精密清洗、阳极氧化和熔射再生等多类服务，并阶段性突破了高精密涂层制备等表面处理技术，形成了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台。公司还自主开发了加工刻蚀液、加工工具和装置，是国内少数实现集成电路先进制程设备和高世代、高电压显示面板制造设备非金属材料多品类供应、规模化量产的企业之一。

行业篇

问：公司所处行业面临的发展机遇有哪些？

杨腾：面临的发展机遇有：1）国家产业政策大力支持；2）市场空间巨大；3）国产化发展加速；4）下游产业技术迭代较快。

问：公司所处行业未来的市场空间如何？

杨腾：人工智能、汽车电子、物联网等新技术和新产品的应用带来庞大的半导体市场需求，半导体设备及零部件位于半导体产业链上游，其市场规模随着下游半导体技术发展和市场需求变化而波动。根据 SEMI 的统计，2024 年，全球设备支出预计达到 1171 亿美元，未来三年将持续增长，中国已连续五年成为全球半导体设备最大市场。中国芯片制造商 2024 年增长 15% 至 885 万片/月，2025 年增长 14% 至 1010 万片/月，国内晶圆厂产能快速扩张为设备零部件及表面处理服务提供了快速发展契机。目前，在人工智能、智能驾驶和人形机器人产业等推动下，无论是 CPU/GPU 还是功率半导体、电源芯片和连接芯片等正迎来新一轮需求增长，晶圆厂产能预计将稳定增长，进而对公司主营产品消耗性零部件的需求大幅提升。

问：公司所处行业的竞争格局如何？

杨腾：国产化发展进程启动前，集成电路和显示面板设备制造领域主要由国外企业主导，其核心零部件供应链也高度依赖海外供应商。相较本土零部件供应商，国外行业企业在经营规模、技术实力及品牌声誉等方面更具优势。近年来，随着本土集成电路和显示面板制造企业日益重视培育本土供应链体系，加之本土设备厂商快速崛起，国内零部件供应商迎来了重要的发展机遇。但囿于资金实力和技术实力，本土供应商普遍呈现以下特征：经营品类较为单一，多聚焦于特定材料或单一产品类别；技术路线以成熟制程配套为主，在先进制程领域配套能力相对薄弱；大多只具备在局部产品领域进行国产化发展，不具备较强的自主设计开发能力和协助客户提升工艺水平的能力。因此，目前市场格局呈现企业较多、规模较小的特点，具备多品类、一体化业务平台和拥有协助客户进行工艺升级能力的企业较少。

问：公司在行业内处于怎样的竞争地位？

王兵：公司是国内少数同时掌握大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积碳化硅等半导体

材料制备技术和硅、石英、陶瓷等硬脆材料零部件精密加工和高精密涂层制备等表面处理技术的企业，系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、重庆市先进智能工厂、重庆博士后工作站、重庆市技术创新示范企业和重庆企业技术中心等。报告期内，公司积极承担国家发展改革重大技术装备攻关专项项目，并协同行业龙头客户开发超厚曲面硅上部电极、氧化铝陶瓷零部件、碳化硅零部件等设备零部件，助力等离子体刻蚀和薄膜沉积等生产设备的核心零部件自主可控，保障供应链安全，推动国内制造业转型升级。

根据弗若斯特沙利文数据：2024 年，直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土企业中，公司在硅零部件市场排名第一，市场份额为 4.5%；在石英零部件市场排名第一，市场份额为 8.8%。2023 年，在半导体及显示面板设备零部件表面处理服务本土服务提供商中，公司排名市场第四，市场份额为 2.8%，其中熔射再生服务市场排名第一，市场份额为 6.3%。

发行篇

问：请介绍公司控股股东、实际控制人的基本情况。

王兵：王兵先生为公司控股股东及实际控制人。截至目前，王兵直接持有公司 44.33% 的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙分别控制公司 10.29%、2.59% 的股份，合计控制公司 57.20% 的表决权。公司的实际控制人在报告期内未发生变更。

夏冰女士为王兵配偶，直接持有公司 3.01% 的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙间接持有公司 1.80% 的股份；王喜才先生为王兵哥哥，直接持有公司 0.24% 的股份；王凤英女士为王兵姐姐，通过重庆臻芯合伙间接持有公司 1.85% 的股份；重庆臻宝合伙、重庆臻宝合伙为王兵控制的公司员工持股平台，分别持有公司 10.29%、2.59% 的股份。上述人员及员工持股平台均为公司实际控制人王兵的一致行动人。

问：其他持有公司 5% 以上股份或表决权的主要股东有哪些？

王兵：截至目前，除实际控制人外，其他持有公司 5% 以上股份的股东包括重庆臻芯合伙、重庆臻宝及其一致行动人杨海斌、杨璐。

问：公司是否有国有股东？

王兵：公司股东集成电路二期基金为国有股东，持有 458.88 万股公司股份，占总股本的 3.94%，股份性质为国有法人股。除此之外，截至目前，公司不存在其他国有股东持股情况。

问：公司具体适用科创板哪一项上市标准？

韩潇：公司 2024 年度和 2025 年度归属母公司股东的净利润（扣非前后孰低值）分别为 14514.26 万元和 22100.95 万元，2025 年的营业收入为 86758.17 万元；公司本次发行前最后一轮市场化融资完成于 2023 年 12 月，投后估值为 26.65 亿元，预计公司市值不低于 10 亿元。因此，根据《科创板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上市条件中的“2.1.2（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”之规定。

问：本次募集资金具体有哪些安排？

韩潇：公司本次募集资金将主要投资于半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目和臻宝科技研发中心建设项目和上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目。通过本次募投项目的实施，公司将扩大硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等零部件产品产能，提高生产效率，加速公司石墨、碳化硅等关键材料及半导体静电卡盘、氮化铝加热器等新型零部件产品的研发与应用，完善公司“原材料+零部件+表面处理”的一体化业务优势，推动公司技术创新，促进国内先进工艺半导体零部件行业国产化水平的提升。

问：公司将通过哪些形式开展投资者关系管理工作？

张静：公司的投资者关系管理渠道多元，主要通过投资者调研、现场参观、股东会、业绩说明会、分析师会议、电话会议、路演活动、媒体对接及新闻发布等，并依托定期报告与临时报告做好常态化沟通。